

# Inhaltsverzeichnis

## Embedding-Technologien und ihre Wertschöpfungskette bei elektronischen Baugruppen

### Teil 1: Embedding-Technologien als Steigerung der Wertschöpfung in der Leiterplatte

Moderation: Dr. Klaus-Dieter Lang, Fraunhofer IZM, Berlin

<b>Embedding-Technologien – ein Überblick zu Entwicklungsstand, Märkten und Anwendungen .....</b>	<b>11</b>
Hannes Stahr, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Leoben, Österreich	

<b>Zukünftige Entwicklungen zum Embedding in Polymersubstraten .....</b>	<b>29</b>
Andreas Ostmann, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, Berlin	

<b>Hochwertige Schablonentechnik für die Integration höhenverteilter Komponenten in die Leiterplatte .....</b>	<b>41</b>
Harald Grumm, Christian Koenen GmbH, Ottobrunn	

<b>Chip-Einbettung in Multilayer Substrate .....</b>	<b>49</b>
Thomas Gottwald, Schweizer Electronic AG, Schramberg	

<b>Dünnchip-Montage für Embedding .....</b>	<b>61</b>
Hannes Kostner, Datacon Technology GmbH, Radfeld, Österreich	

<b>Die funktionelle Integration von aktiven und passiven Komponenten in die Leiterplatte im industriellen Umfeld .....</b>	<b>73</b>
Dr. Jan Kostelník / Frank Ebling, Würth Elektronik GmbH und Co. KG, Rot am See	

### Teil 2: Anwenderanforderungen und Erfahrungen zum Einsatz von Embedding-Verfahren

Moderation: Dr. Werner Witte, BuS Elektronik GmbH & Co. KG, Riesa

<b>Anwendung von Embedding Technologien aus Sicht eines Herstellers von Automobilelektronik .....</b>	<b>79</b>
Thomas Hofmann / Bernhard Schuch, Continental AG, Nürnberg	

<b>Einbett-Technologie in der Power-Elektronik .....</b>	<b>87</b>
Dr. Oliver Hellmund, Infineon Technologies AG, Neubiberg	

<b>Integration planarer Polymerwellenleiter .....</b>	<b>89</b>
Dr. Felix Betschon, Vario-Optics AG, Heiden, Schweiz	
<b>Heatsinkleiterplatten für Power-LED-Anwendungen .....</b>	<b>103</b>
Martin Sachs, db electronic Daniel Böck GmbH, Groß-Gerau	
<b>Assembly und Packaging von Elektronikmodulen für medizinische Implantate – ein Überblick .....</b>	<b>111</b>
Jörg Goßler, Micro Systems Engineering GmbH, Berg	
<b>Zukünftige Leiterplatten- und Baugruppentecnologien für Avionik und Defence .....</b>	<b>127</b>
Josef Denzel, EADS Deutschland GmbH, Ulm	
<b>Anwendungstrends und Marktfelder der Embedding-Technologien im Vergleich zur Standard HDI-Technik .....</b>	<b>141</b>
Dr. Markus Riester, maris TechCon, Graz, Österreich	
<b>Messekalender .....</b>	<b>159</b>